



2017年6月28日

各 位

会 社 名 株式会社 東芝
東京都港区芝浦1-1-1
代表者名 代表執行役社長 綱川 智
(コード番号: 6502 東、名)
問合せ先 執行役常務 広報・IR部長
長谷川 直人
Tel 03-3457-2100

東芝メモリ株式会社四日市工場第6製造棟に導入する生産設備等の投資について

当社は、本日開催の取締役会において、3次元フラッシュメモリ「BiCS FLASH™」の生産拡大のために当社子会社である東芝メモリ株式会社（以下、東芝メモリ）の四日市工場（三重県四日市市）にて建設中の第6製造棟に導入する生産設備と同製造棟第2期分の建設の投資について、下記のとおり承認いたしましたので、お知らせいたします。

記

2017年2月9日付プレスリリース「四日市工場の第6製造棟および開発センターの起工について」にてお知らせのとおり、3次元フラッシュメモリの生産拡大のため、四日市工場に第6製造棟を建設しており、2018年夏に第1期分が竣工する予定です。

このたび、エンタープライズ用サーバやデータセンター向けを中心に3次元フラッシュメモリの需要拡大が見込まれることから、これに対応すべく、第6製造棟第1期分の生産設備及び同製造棟第2期分の建屋建設投資として、総額約1,800億円の投資を東芝メモリが2017年度中に実施することについて、当社取締役会にて承認されました。

これにより、第6製造棟第1期分の建設進捗に合わせ、第1期分の建屋内に96層積層プロセスを用いた3次元フラッシュメモリ固有の製造工程を担う最先端の成膜装置やエッチング装置などを導入し、また、同棟第2期分の建屋については、2017年9月に起工し、2018年末に竣工する予定です。具体的な生産能力、生産計画等については、市場動向を踏まえ、今後決定してまいります。

なお、第6製造棟に導入する生産設備に対する米国サンディスク社による投資参加の有無につきましては、現在同社と協議中ですが、仮に同社が参加しない場合には、東芝メモリ単独で、生産設備を導入する予定です。

また、今回の投資は2016年3月17日付「半導体製造棟の建設について」にて公表の3カ年の投資額約3,600億円に含まれます。

以 上